第62期 定時株主総会

TOKYO ELECTRON

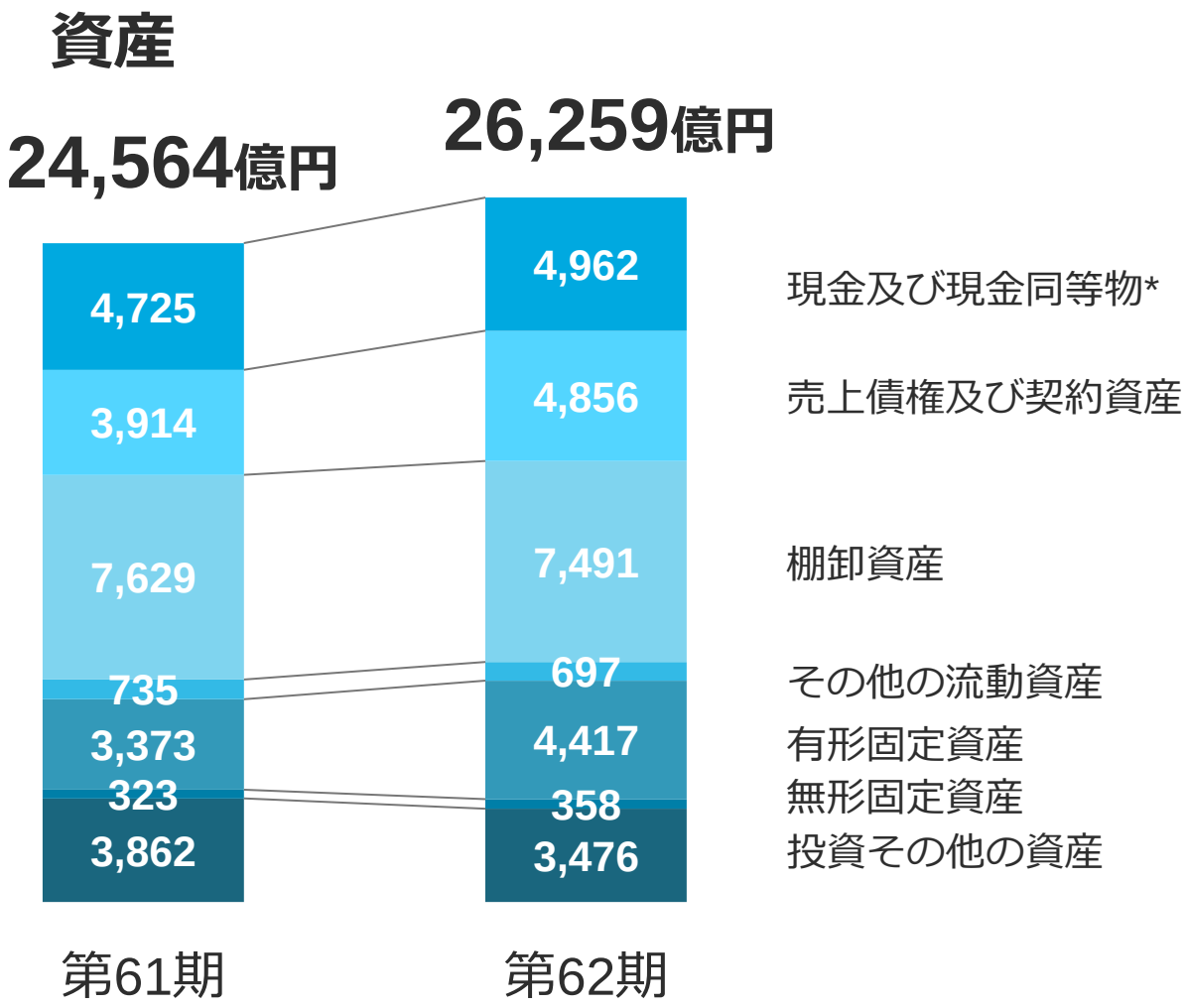
2025年6月17日

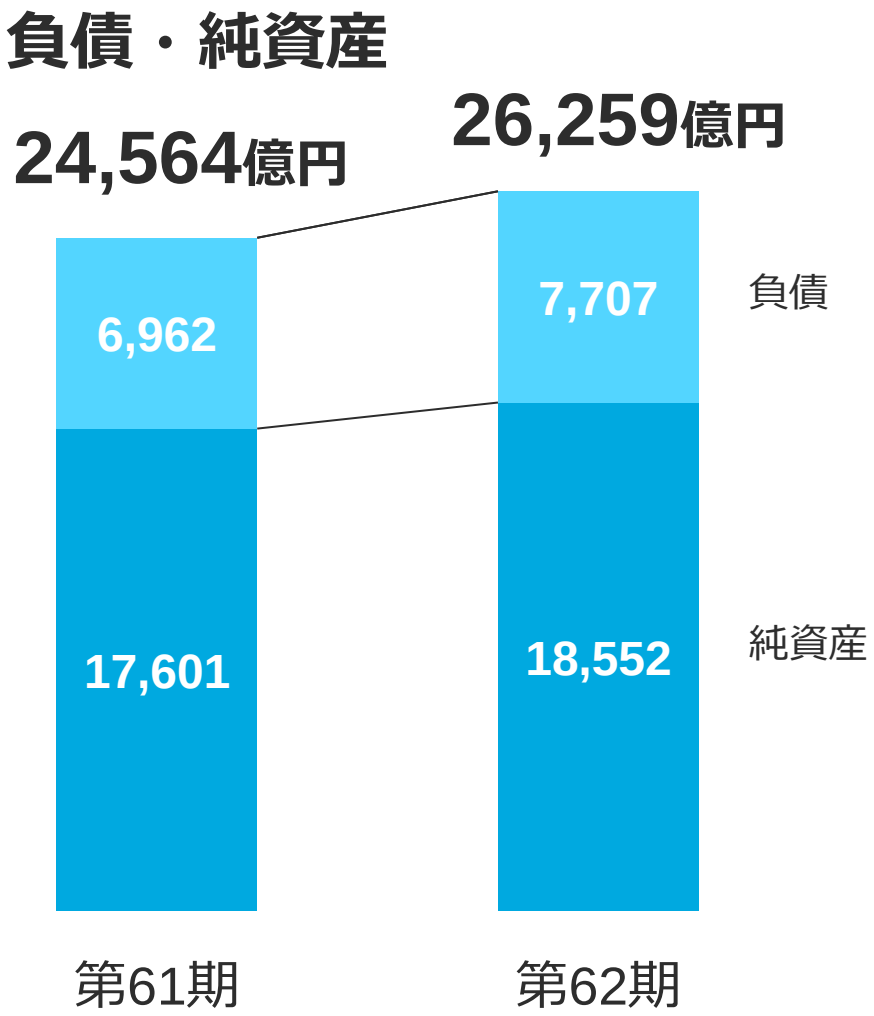
第62期　業績報告

連結損益計算書

	第61期（%）		第62期（%）		増減
売上高	1兆8,305億円	100.0	2兆4,315億円	100.0	+33%
売上総利益	8,302億円	45.4	1兆1,462億円	47.1	+38%
営業利益	4,562億円	24.9	6,973億円	28.7	+53%
経常利益	4,631億円	25.3	7,077億円	29.1	+53%
税引前利益	4,734億円	25.9	7,061億円	29.0	+49%
親会社株主に帰属する当期純利益	3,639億円	19.9	5,441億円	22.4	+50%
1株当たり当期純利益	784円		1,182円		+51%
ROE	21.8%		30.3%		+8.5pts

連結貸借対照表





*現金及び現金同等物：現預金＋短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

単独財務諸表の概要

■ 損益計算書

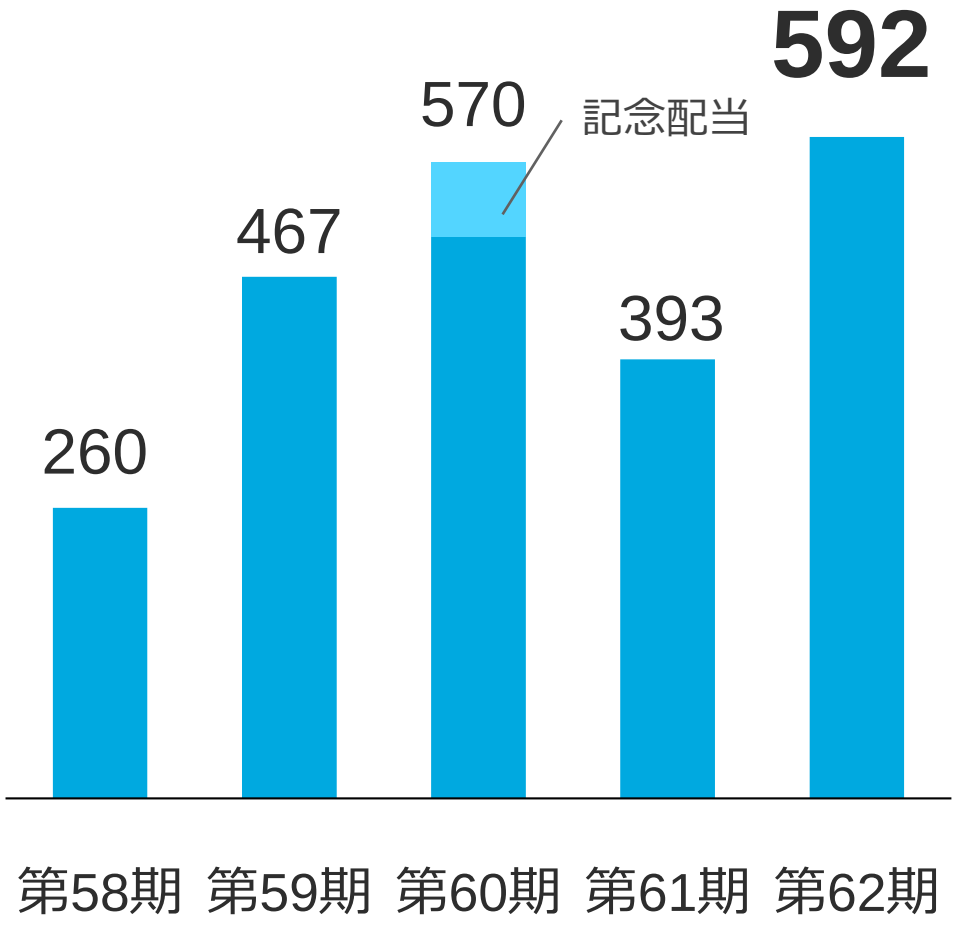
	第61期	(%)	第62期	(%)	増減
売上高	1兆6,252億円	100.0	2兆2,040億円	100.0	+5,788億円
売上総利益	5,373億円	33.1	6,650億円	30.2	+1,277億円
営業利益	4,017億円	24.7	5,062億円	23.0	+1,044億円
経常利益	4,413億円	27.2	5,502億円	25.0	+1,088億円
税引前利益	4,413億円	27.2	5,494億円	24.9	+1,081億円
当期純利益	3,401億円	20.9	4,248億円	19.3	+846億円

■ 貸借対照表

	第61期	(%)	第62期	(%)	増減
資産合計	1兆8,608億円	100.0	1兆8,755億円	100.0	+146億円
負債合計	6,614億円	35.5	6,872億円	36.6	+258億円
純資産合計	1兆1,993億円	64.5	1兆1,882億円	63.4	△111億円
負債・純資産合計	1兆8,608億円	100.0	1兆8,755億円	100.0	+146億円

第62期 配当金

【1株当たり配当金（円）】

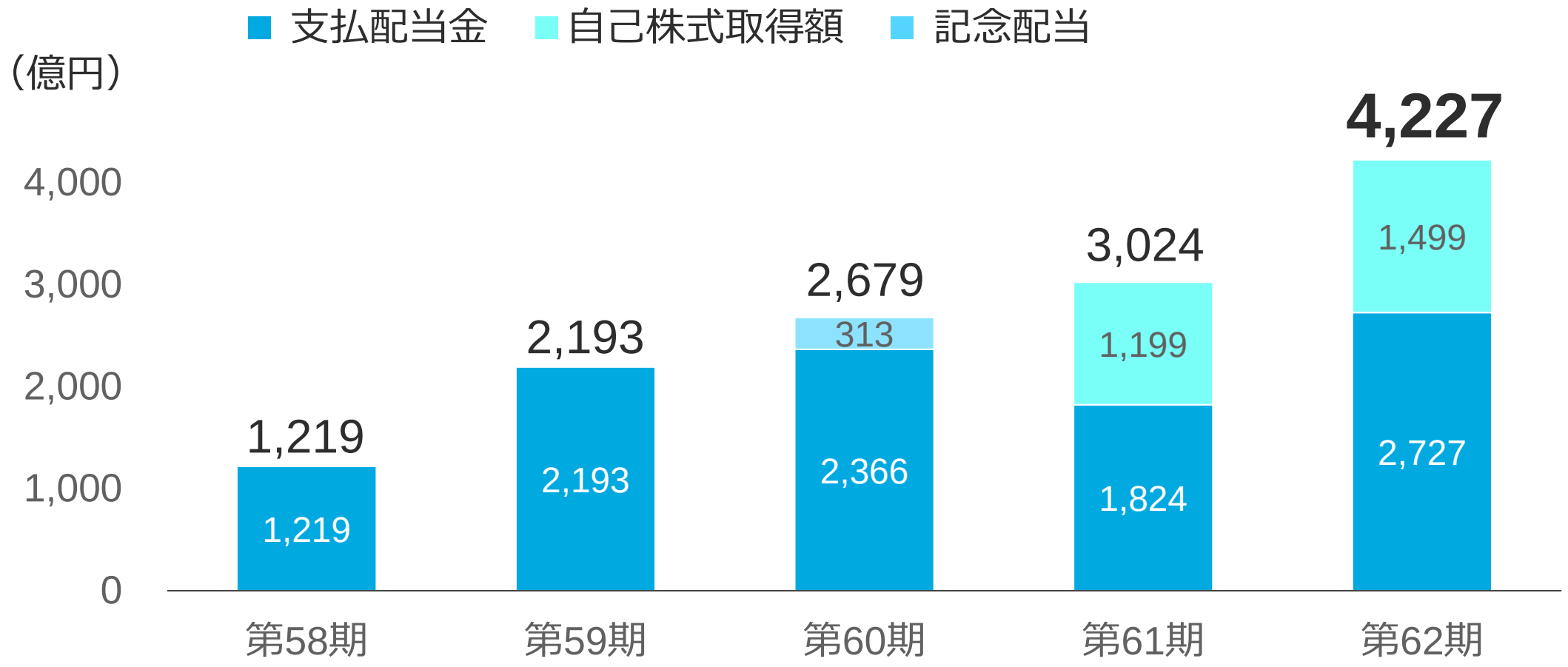


中間	期末	年間
265円	327円	592円

配当総額	連結配当性向
2,727億円	50.1%

（注）第58期～第60期の1株当たり配当額は、第58期の期首に株式分割がおこなわれたと仮定した金額を記載しています。

第62期 総還元額


支払配当金
自己株式取得額
記念配当
（億円）
4,000
3,000
2,000
1,000
0
1,219
1,219
2,193
2,193
2,679
313
2,366
3,024
1,199
1,824
4,227
1,499
2,727
第58期
第59期
第60期
第61期
第62期

第63期　業績見通し

足元の事業環境（本年の半導体製造装置市場）

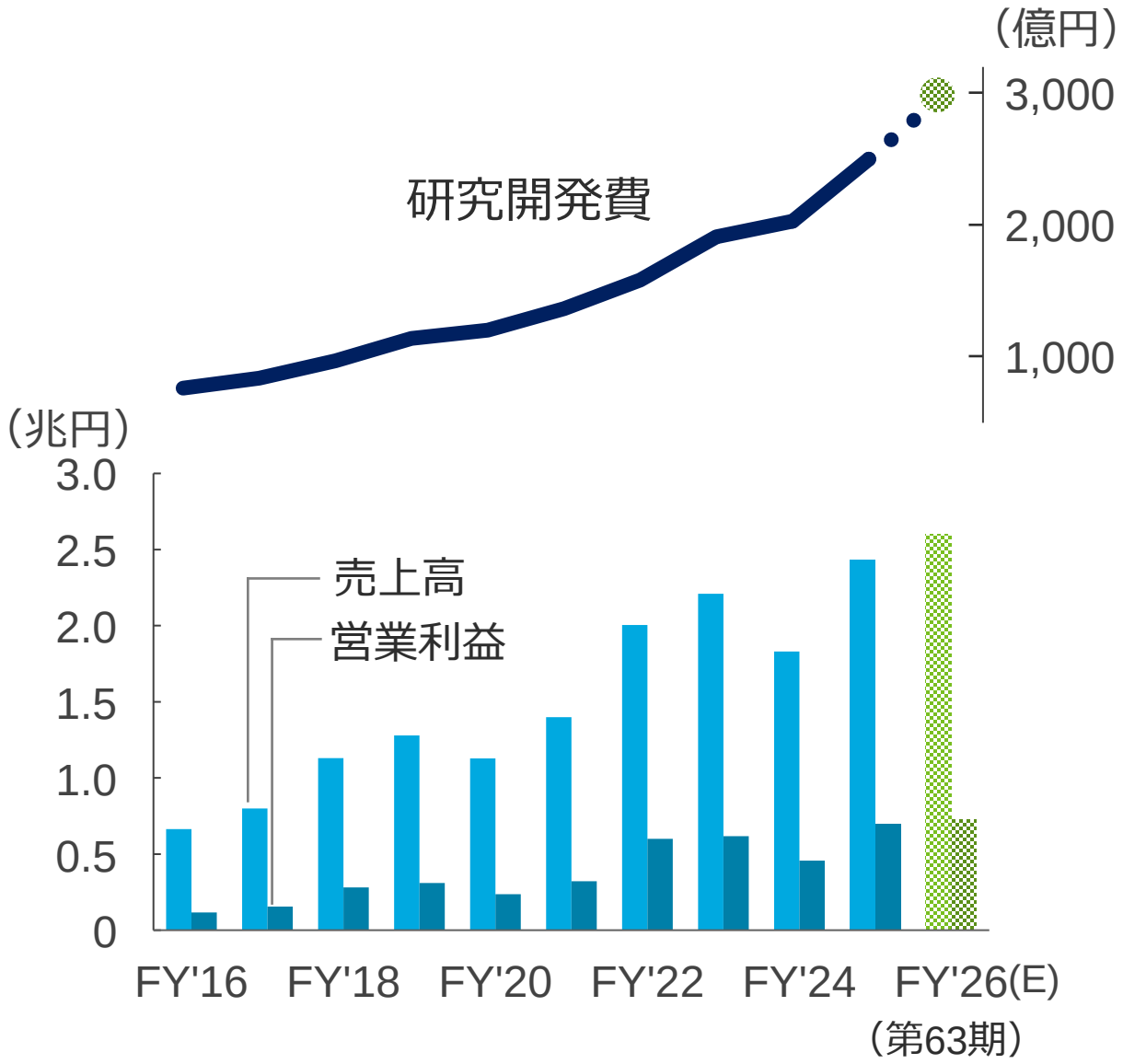
- **市場規模は前年と同水準の見通し**
  - 車載やパワー半導体、中国新興メーカーの投資は一服
  - 引き続き旺盛なAIサーバー向け投資
    - 最先端ロジック（2nm）とHBM*が市場を牽引　* High Bandwidth Memory
  - 地政学的な動向は注視

第63期 連結業績見通し

	上期	下期	通期
売上高	1兆1,500億円	1兆4,500億円	2兆6,000億円
売上総利益	5,270億円 45.8%	7,010億円 48.3%	1兆2,280億円 47.2%
営業利益	2,880億円 25.0%	4,390億円 30.3%	7,270億円 28.0%
経常利益	2,930億円	4,430億円	7,360億円
税引前利益	2,930億円	4,430億円	7,360億円
親会社株主に帰属する当期純利益	2,240億円	3,420億円	5,660億円

2期連続 最高益を見込む

継続的な研究開発投資



研究開発費

3,000億円

（第63期）

将来の成長ポテンシャルを最大限取り込む

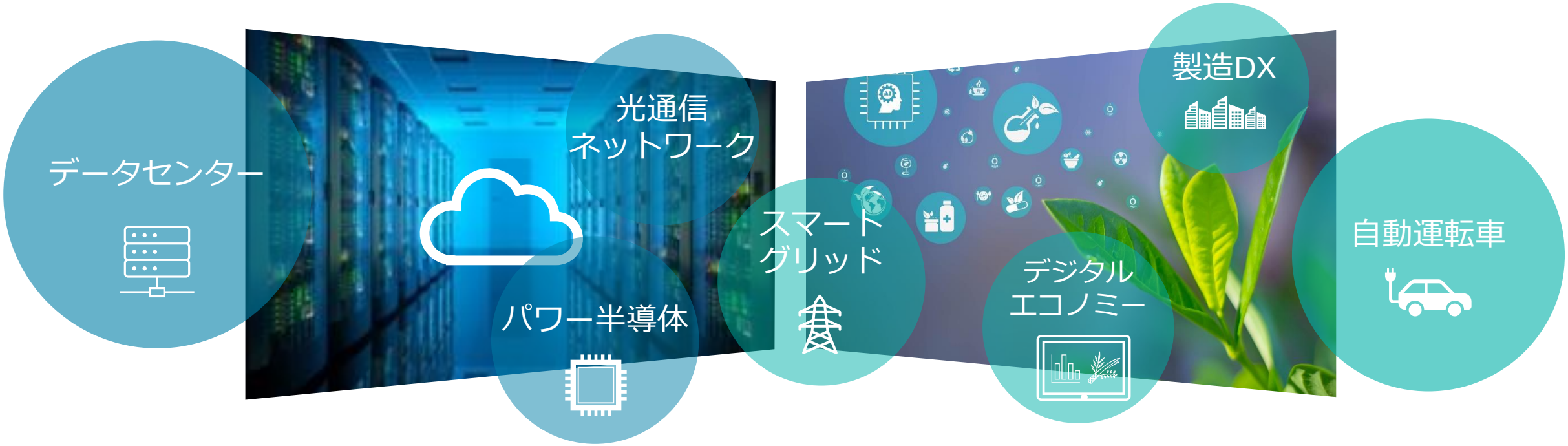
中長期的な利益と継続的な企業価値の向上を目指して

1. 事業環境
2. 中期経営計画
3. さらなる企業価値向上を目指して
4. 株主の皆さまへの還元

1. 事業環境

VUCAの時代
Volatility
変動性
Uncertainty
不確実性
Complexity
複雑性
Ambiguity
曖昧性

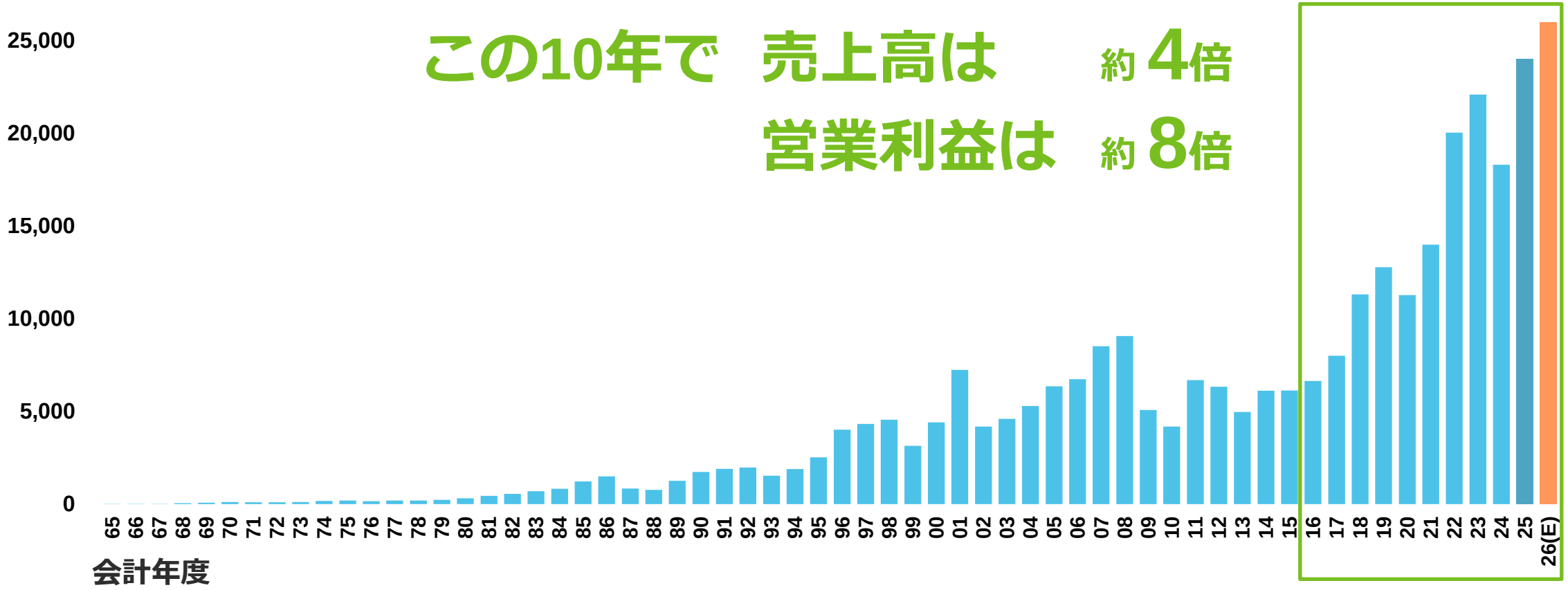
Digital × Green



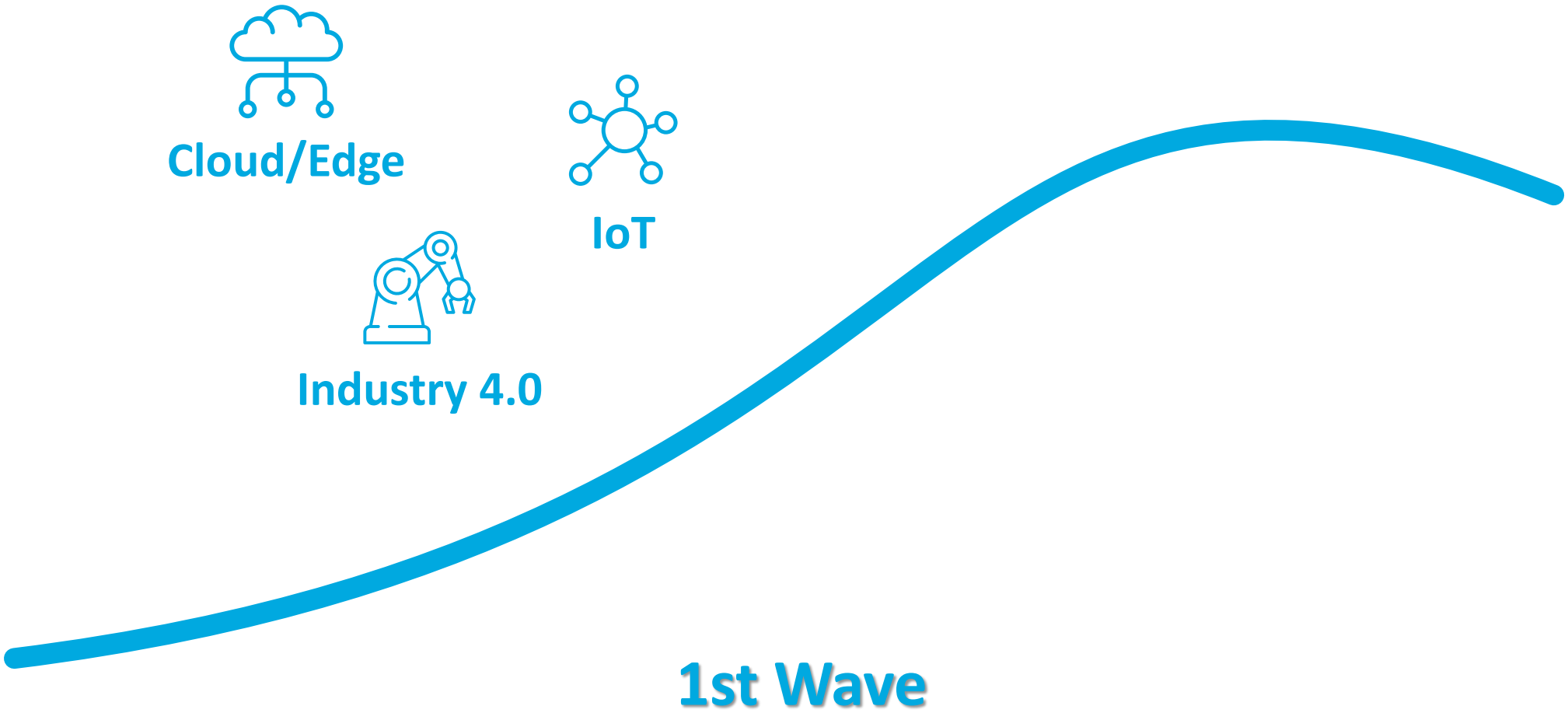
“Green by Digital” & “Green of Digital”

東京エレクトロンの歴史

連結売上高（億円）

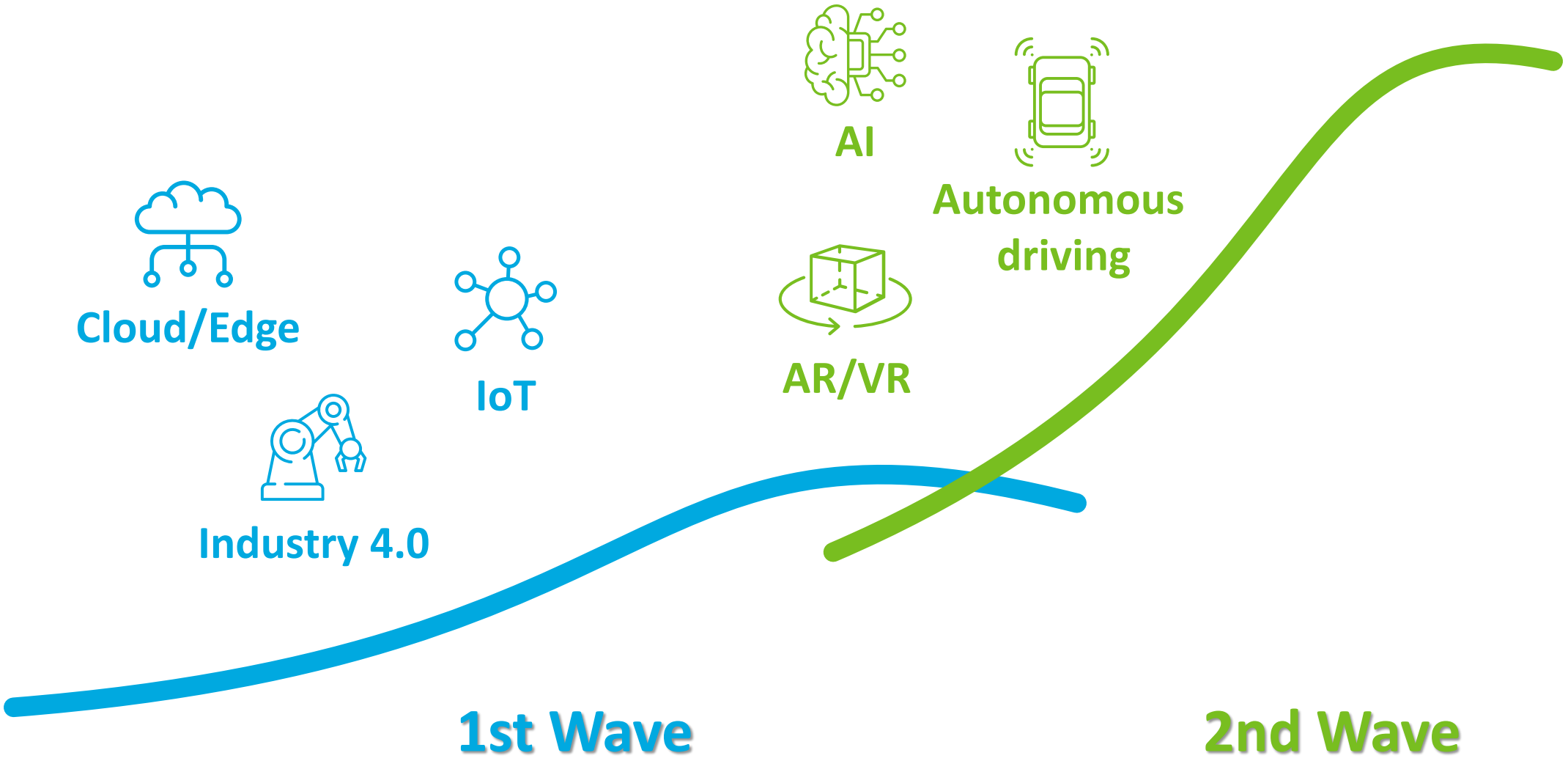


半導体市場の展望



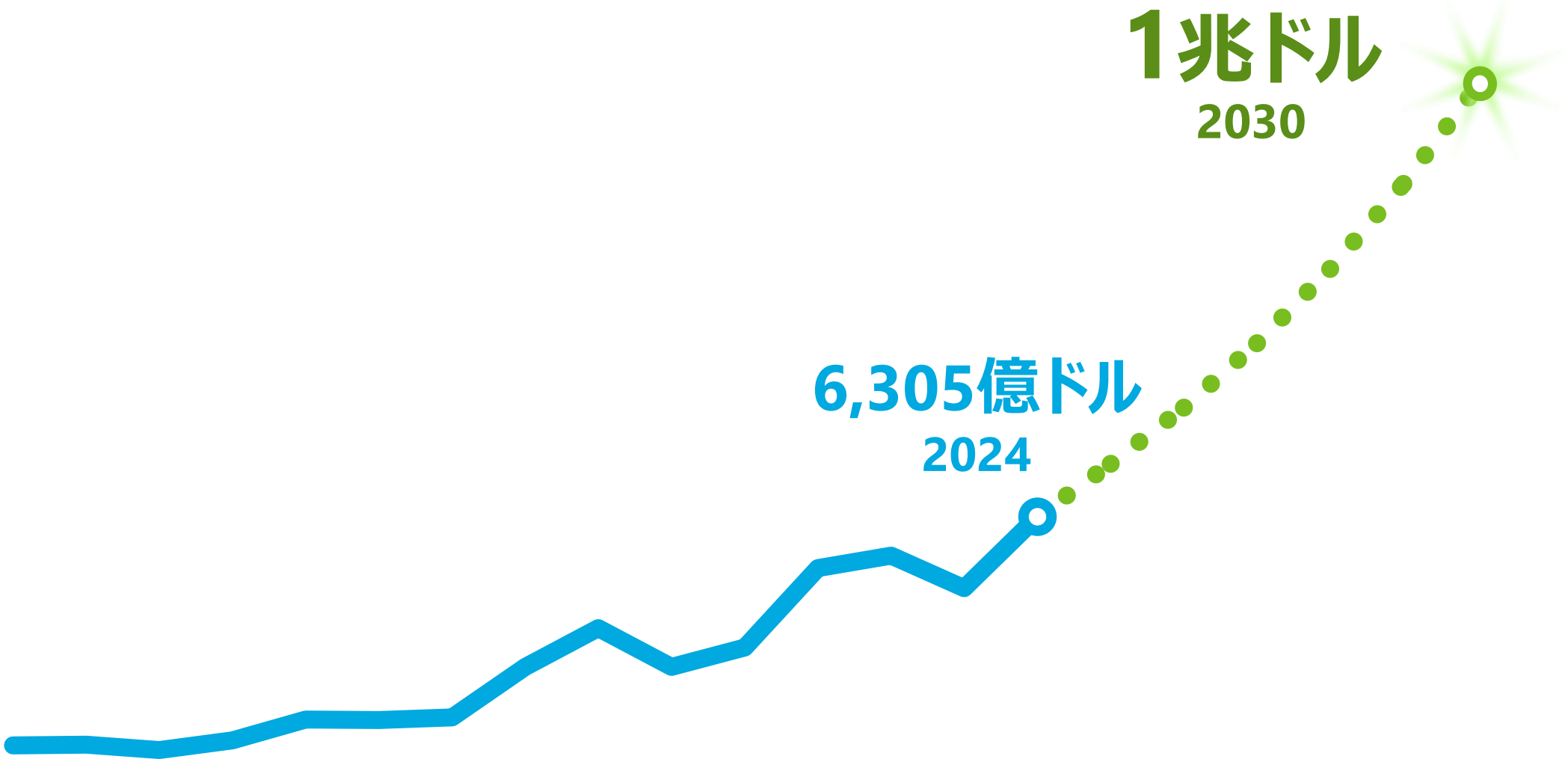
Source: SEMI 2024

半導体市場の展望



Source: SEMI 2024

半導体市場の展望



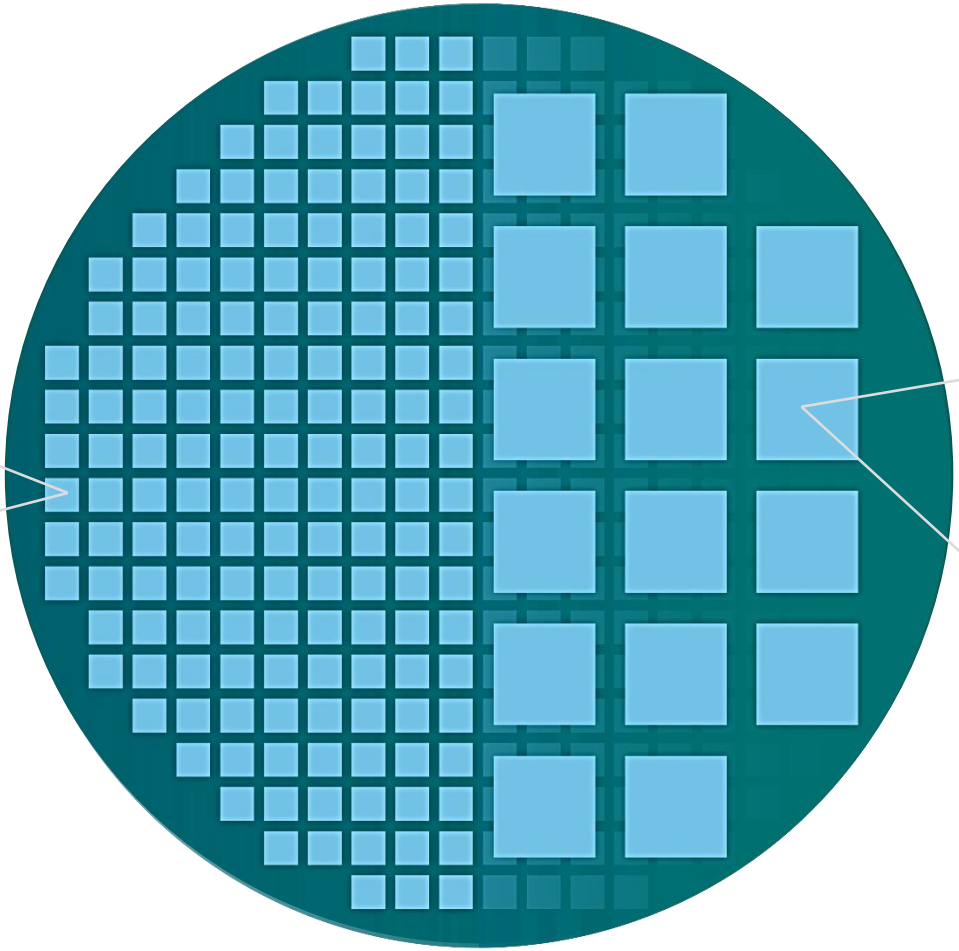
Source:2010-2024 (WSTS, May 2025)

AIサーバーに不可欠な最先端半導体

スマートフォン

160億
トランジスタ

チップサイズ
~100mm^2



AIサーバー

800億
トランジスタ

チップサイズ
~800mm^2

Source: Omdia 4nm node

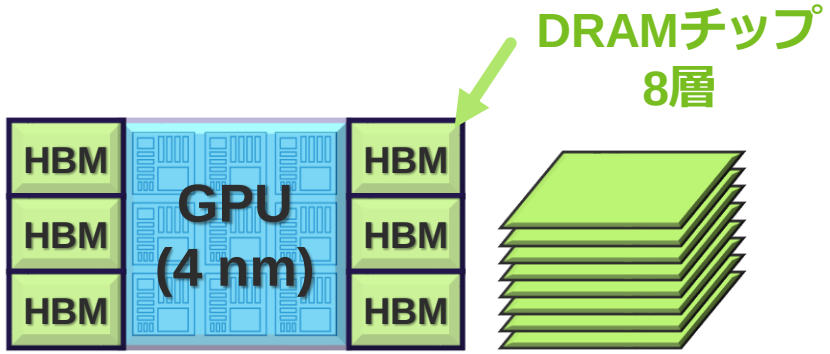
AIサーバーに不可欠な最先端半導体

TEL estimate

4 nm世代～2024

トランジスタ数 **800**億個

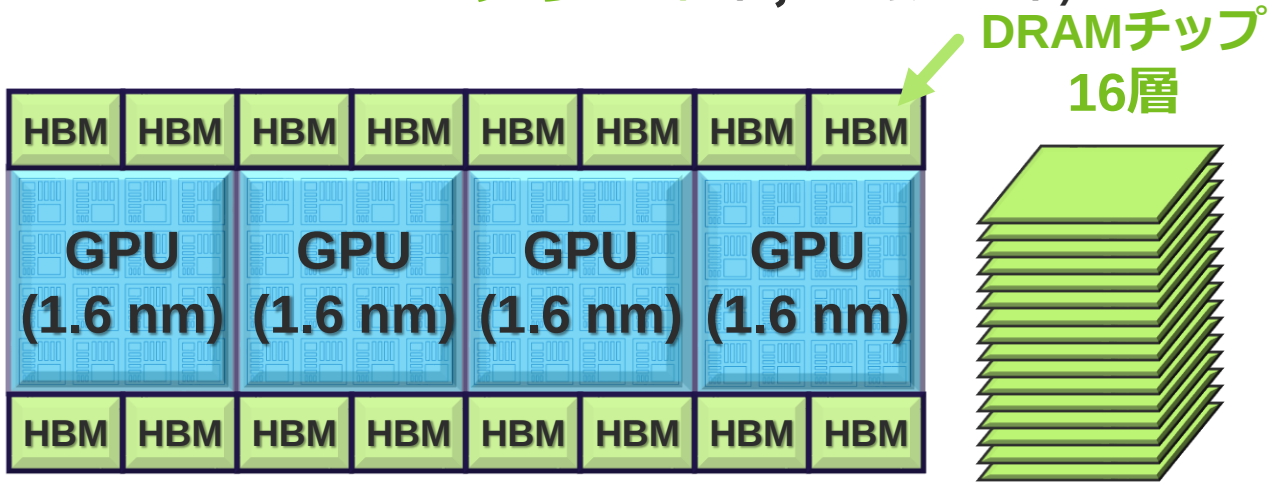
メモリ容量 **141** ギガバイト



1.6 nm世代 @2028

トランジスタ数 ～**6,400**億個

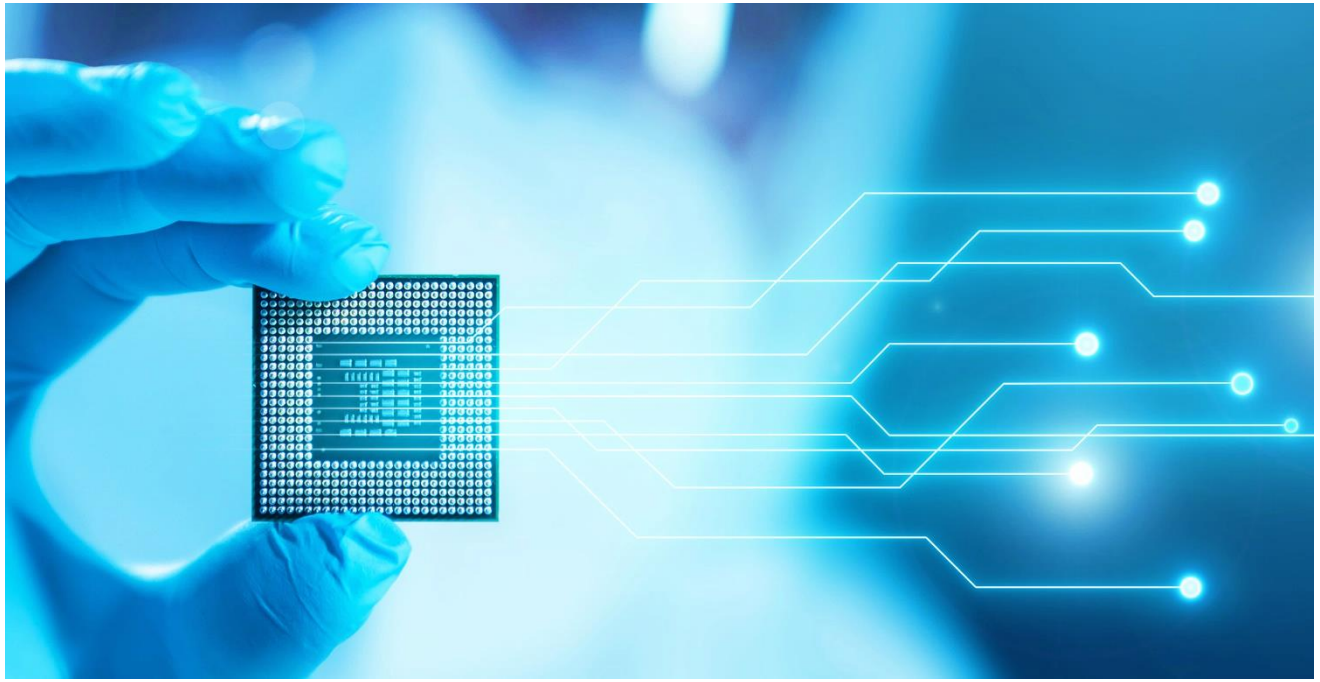
メモリ容量 **1**テラバイト（1,024ギガバイト）



GPU ：Graphic Processing Unit
HBM ：High Bandwidth Memory

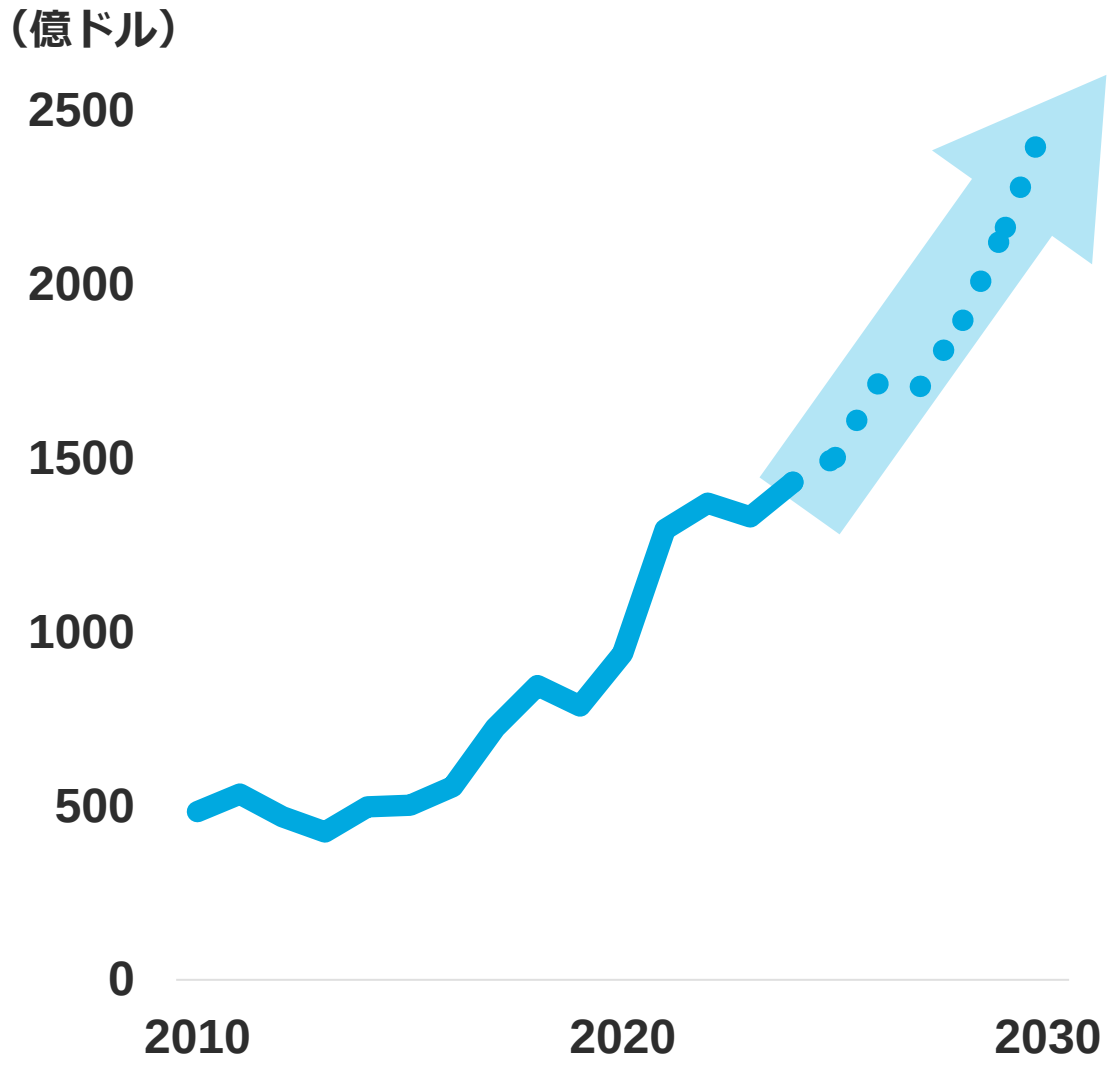
トランジスタの微細化・集積化、メモリの大容量化が進む

半導体の技術革新は止まらない



高速・大容量・高信頼性・低消費電力を追求

半導体製造装置市場の展望

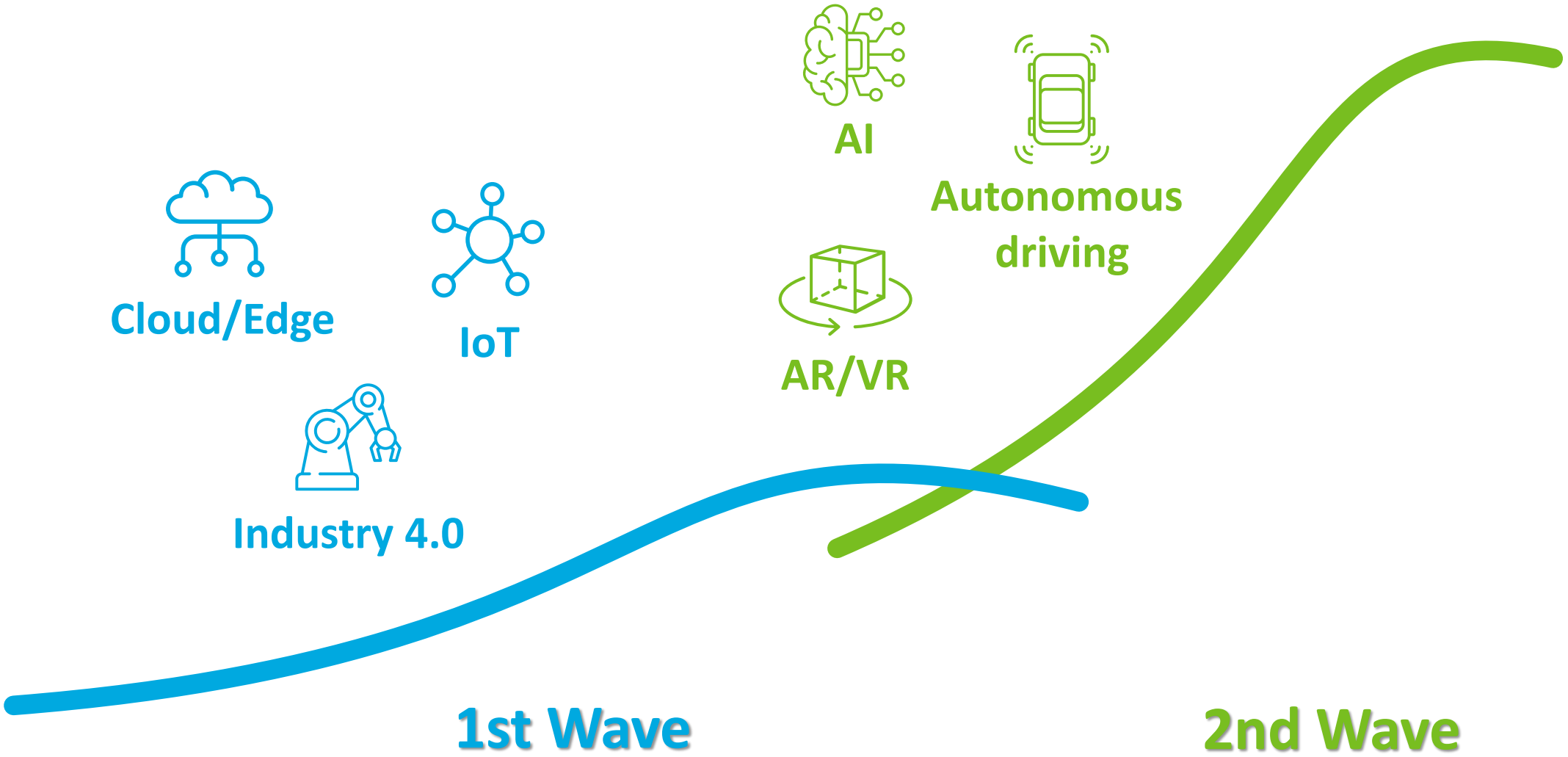


Source : TechInsights (April, 2025)

2024年実績から
2030年までの6年間で

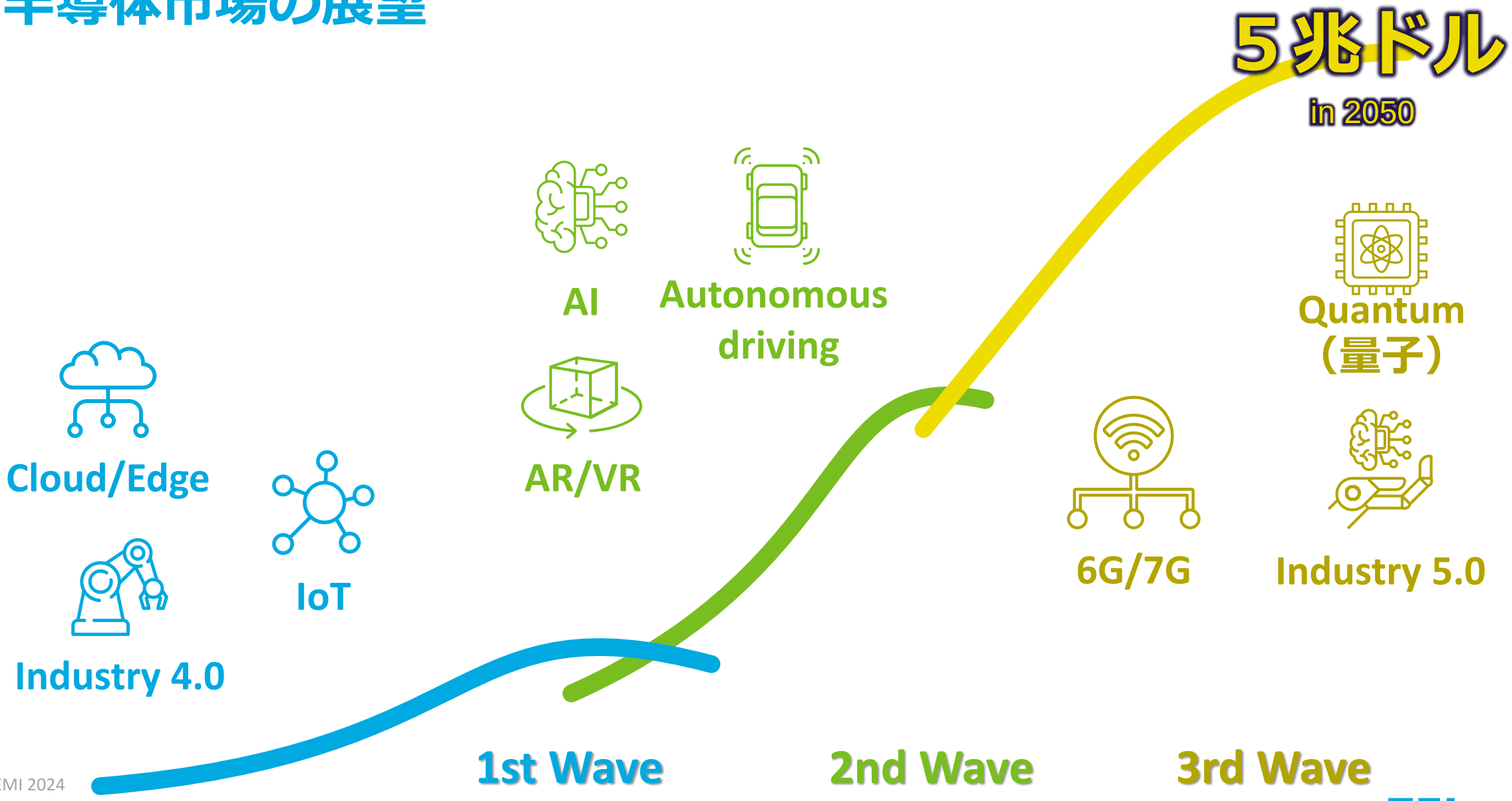
約2倍

半導体市場の展望



Source: SEMI 2024

半導体市場の展望



Source: SEMI 2024

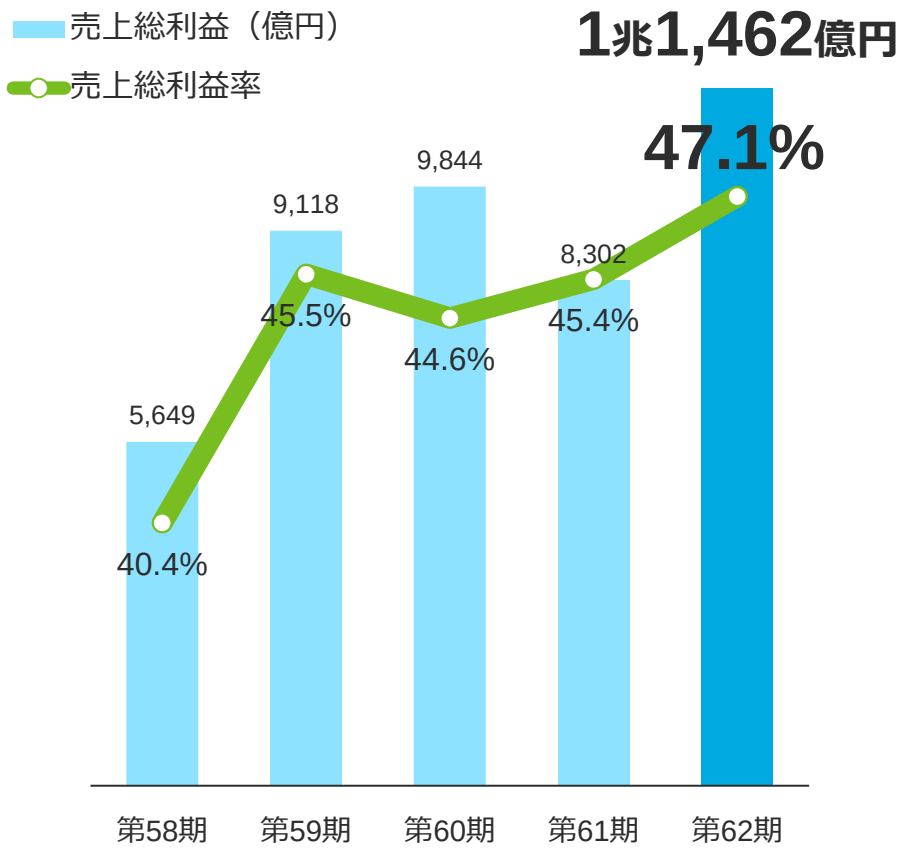
2. 中期経営計画

中期経営計画 財務目標（2022年6月発表）

財務目標 (~2027年3月期)	
売上高	≥ 3兆円
営業利益率	≥ 35%
ROE	≥ 30%

中期経営計画 取り組みの進捗

売上総利益と売上総利益率の推移



2024年 前年比シェアアップのハイライト

塗布・現像装置	+ 1.8 pts 2024年シェア 92.3%	↗
エッチング装置	+ 5.8 pts 2024年シェア 27.4%	↗

*1 Gartner

62期 売上高ハイライト

ウェーハ接合装置	売上高は2年で 3倍	↗

*1 チャートはGartnerリサーチを基にTELが作成。ここにある数値はTELが算出したものです。Source：Gartner®, "Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2024", Bob Johnson, Menglin Cao, 21 April 2025, Revenue from Shipments basis.［塗布・現像装置：Photoresist Processing (Track) /エッチング装置：Dry Etch / ウェーハ接合装置：Wafer Bonders］Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。GARTNERは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved.
本書に記載するGartnerのコンテント（以下「Gartnerコンテント」）は、Gartnerシンジケート・サブスクリプション・サービスの一部としてGartner, Inc.(以下「Gartner」)が発行したリサーチ・オピニオンまたは見解を表すものであり、事実を述べているものではありません。Gartnerコンテントの内容はいずれも、そのコンテントが発行された当時の内容であり、本書が発行された日の内容ではありません。また、Gartnerコンテントに記載されている見解は予告なく変更されることがあります。

稼ぐ力は着実に向上

ビジネス環境におけるリスク

半導体の重要性は変わらない

コアコンピタンスをさらに磨く

TELの強みを活かす

Only one

成膜	塗布現像	エッチング	洗浄

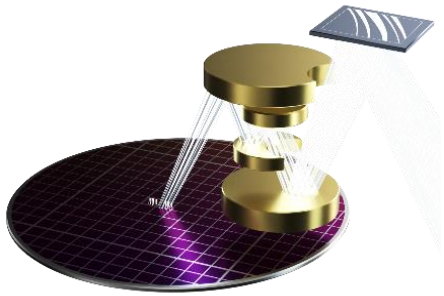
4連続工程に装置をもつ世界唯一のメーカー

TELの強みを活かす

Share 100%

塗布現像

EUV露光



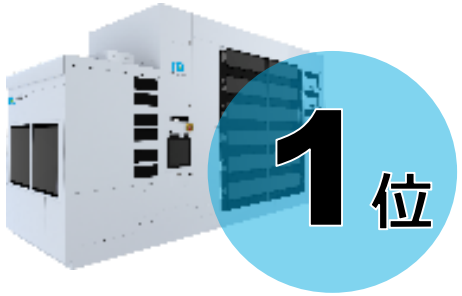
EUV: Extreme Ultraviolet
極端紫外線

EUV露光用 塗布現像装置シェア 100%

*当社推定

TELの強みを活かす

当社推定

塗布現像	洗浄	プラズマエッチング	ガスケミカルエッチング
 1位	2位	2位	1位

拡散炉	バッチ成膜	メタル成膜	プローバ	ボンダー
1位	1位	2位	1位	2位

シェア世界 1位、2位の製品群

TELの強みを生かす

No.1

年間装置出荷台数

約4,000～6,000台*1

世界装置出荷台数

業界最大の 96,000台*2

*1 2025年3月末時点
*2 2025年3月末時点

業界No.1の装置出荷実績

TELの強みを生かす

半導体製造装置業界トップの特許保有数

グローバル・イノベーターとして社外から表彰

クラリベイト社

Top 100 Global Innovators 2025

4年連続受賞

2019-2023年の5年間の特許の件数、影響力、投資レベルを評価

レクシスネクシス社

Innovation Momentum 2025: The Global Top 100

3年連続受賞

過去2年間の特許の市場的価値、技術的価値を評価

未来に向けた成長投資　2025年3月期～2029年3月期 5か年の合計

研究開発	設備投資	人材採用
1.5 兆円	7,000 億円	10,000 人 毎年 2,000人

さらなる成長に向け積極的な投資を計画

設備投資

2025年4月 竣工
TEL
新開発棟（宮城）

2025年秋 竣工予定
生産・物流センター（岩手）

2025年秋 竣工予定
新開発棟（熊本）

2027年夏 竣工予定
TEL
宮城生産革新センター

TELの装置を通らない
半導体は世の中にない

利益は製品・サービスの価値の大きさを示す尺度

強みをさらに磨く

3. さらなる企業価値向上を目指して

当社のビジョン

半導体の
技術革新に貢献する
夢と活力のある会社

Innovation

世の中の持続的な発展を支える
半導体の技術革新を追求

Profitability

付加価値の高い最先端の装置と
技術サービスを継続的に創出

People

社員は価値創出の源泉
ステークホルダーエンゲージメント

CSV

Creating Shared Value

企業活動＝社会的・経済的価値の創出

TSV

TEL’s Shared Value

デジタル化と地球環境保全の両立

“半導体の技術革新が不可欠”

Net Zero

2040年までに達成

スコープ１＆２　：事業活動における電力などのエネルギー使用による排出
スコープ３　　：販売した装置の使用や廃棄、資材の購入や物流などにおける排出

E-COMPASS

Environmental Co-Creation by Material, Process and Subcomponent Solutions

半導体

デバイスの高性能化と
低消費電力化

製造装置

装置のプロセス性能と
環境性能の両立

事業活動

事業活動全体における
CO_2排出量削減

サプライチェーン全体で
半導体の技術革新と環境負荷低減を推進

社員は価値創出の源泉

新卒エントリー数（日本）	定着率
25,245名 （25年4月入社対象：採用人数543名） 6年間で 約3倍	**99.1%** 日本 （97.6% グローバル）

持続的な成長に向け、人材の確保と定着を図る

企業価値のさらなる向上に向けて

攻め & **攻め**

ワールドクラスの
営業利益率と
30%以上のROE

- 安全
- 品質
- 法令遵守
- エンゲージメント
- リスクマネジメント
  & セキュリティ

4. 株主の皆さまへの還元

還元に関する基本的な考え方

付加価値の高い最先端の装置と
技術サービスを継続的に創出

▼

短中長期の利益を同時に志向
持続的な企業価値の向上

▼

ステークホルダーへの適切な還元

配当政策

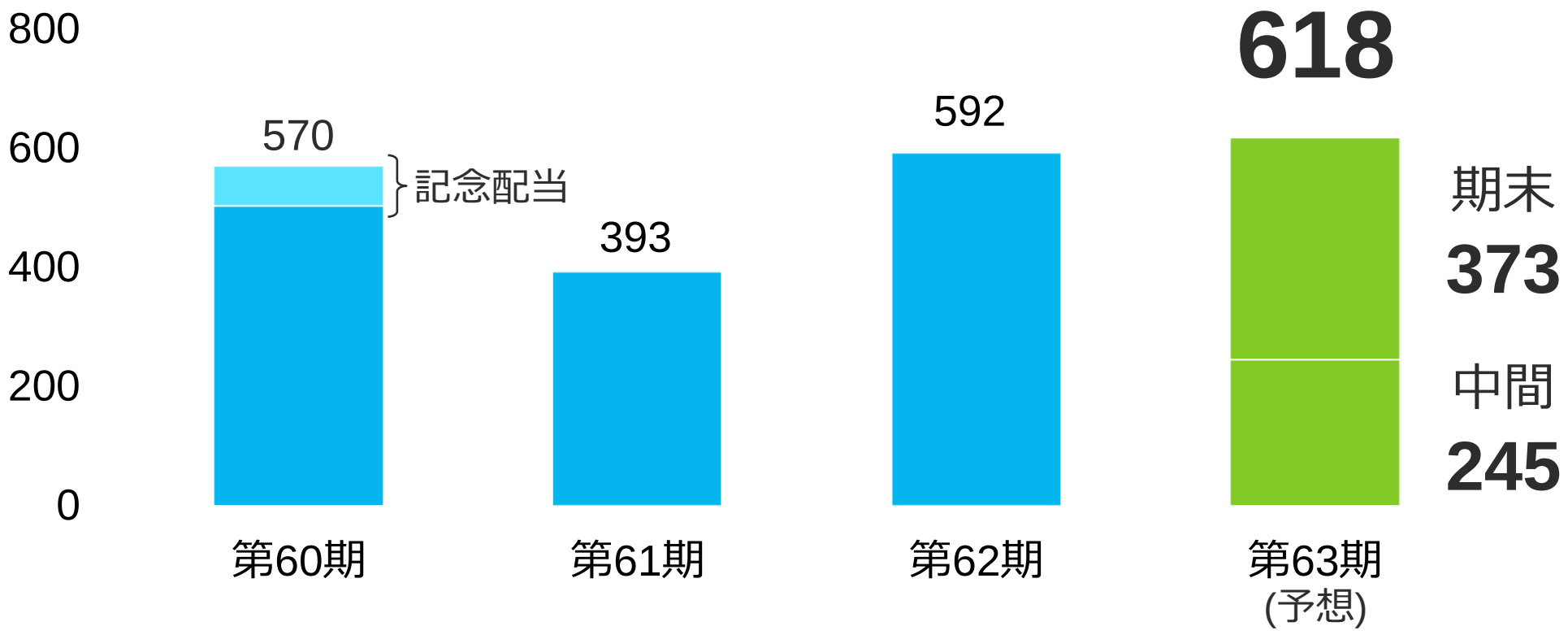
連結配当性向：50%

但し、1株当たり年間配当金50円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

第63期 配当金予想

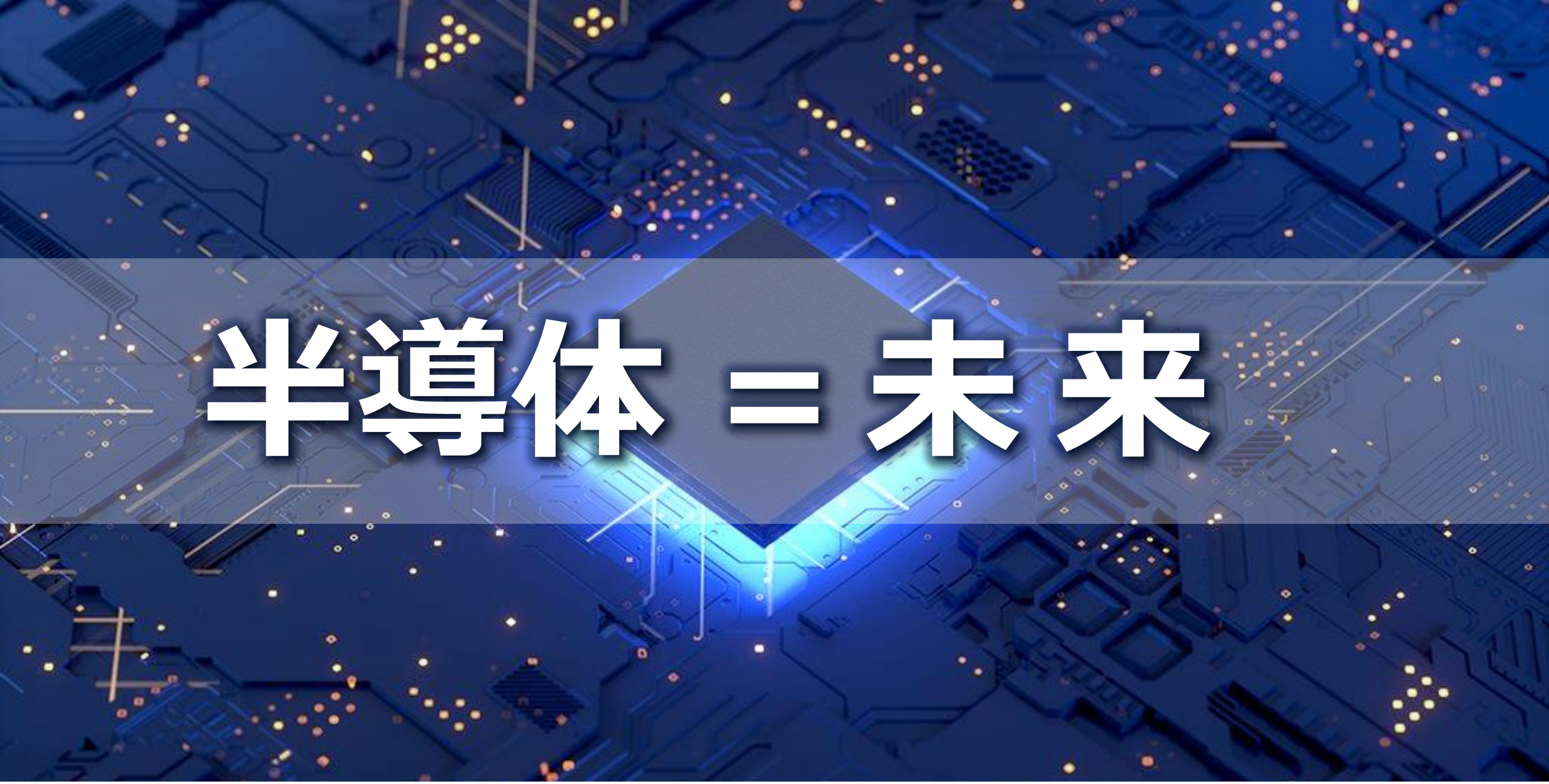
【1株当たり配当金（円）】



1株当たりの通期配当金は 618円を予定

（注）第60期の1株当たり配当額は、第60期の期首に株式分割がおこなわれたと仮定した金額を記載しています。

今後も一層の株主価値向上に
取り組むとともに
すべてのステークホルダーの期待に
応えてまいります


半導体＝未来

さらなる成長フェーズ

企業の成長は 人

世の中にない技術を創造

挑戦と進化を続ける

世界 ナンバーワン
を目指して

TEL

TOKYO ELECTRON

決議事項

1．取締役 ８名選任の件

2．監査役 ２名選任の件

3．取締役の短期業績連動報酬額決定の件

4．取締役の中長期業績連動報酬等の決定の件

5．取締役の非業績連動報酬等の決定の件

6．社外取締役に対する株式報酬の額の改定の件

第１号議案

取締役 ８名選任の件

第１号議案　取締役８名選任の件

＜取締役候補者氏名＞

1. 河合（かわい）　利樹（としき）
2. 佐々木（ささき）　貞夫（さだお）
3. 田原（たはら）　計志（かずし）（新任）
4. 佐々木（ささき）　道夫（みちお）
5. 市川（いちかわ）　佐知子（さちこ）
6. ジョセフ・クラフト
7. 鈴木（すずき）　ゆかり
8. 篠原（しのはら）　幸弘（ゆきひろ）（新任）

注）佐々木道夫氏、市川佐知子氏、ジョセフ・クラフト氏、鈴木ゆかり氏及び篠原幸弘氏につきましては、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

第２号議案

監査役 ２名選任の件

第２号議案　監査役２名選任の件

＜監査役候補者氏名＞

1. 松浦（まつうら）　次彦（つぐひこ）（新任）
2. 牧野（まきの）　あや子（こ）（新任）

注１）松浦次彦氏及び牧野あや子氏を監査役候補者とする件につきましては、
監査役会の同意を得ております。
注２）牧野あや子氏については、
会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。

役員報酬議案について

【役員報酬 基本方針のポイント】

グローバルで競争力のある水準

⇒ワールドクラスの利益創出に向け
優秀な人材の継続的な採用と確保

企業価値向上との高い連動性

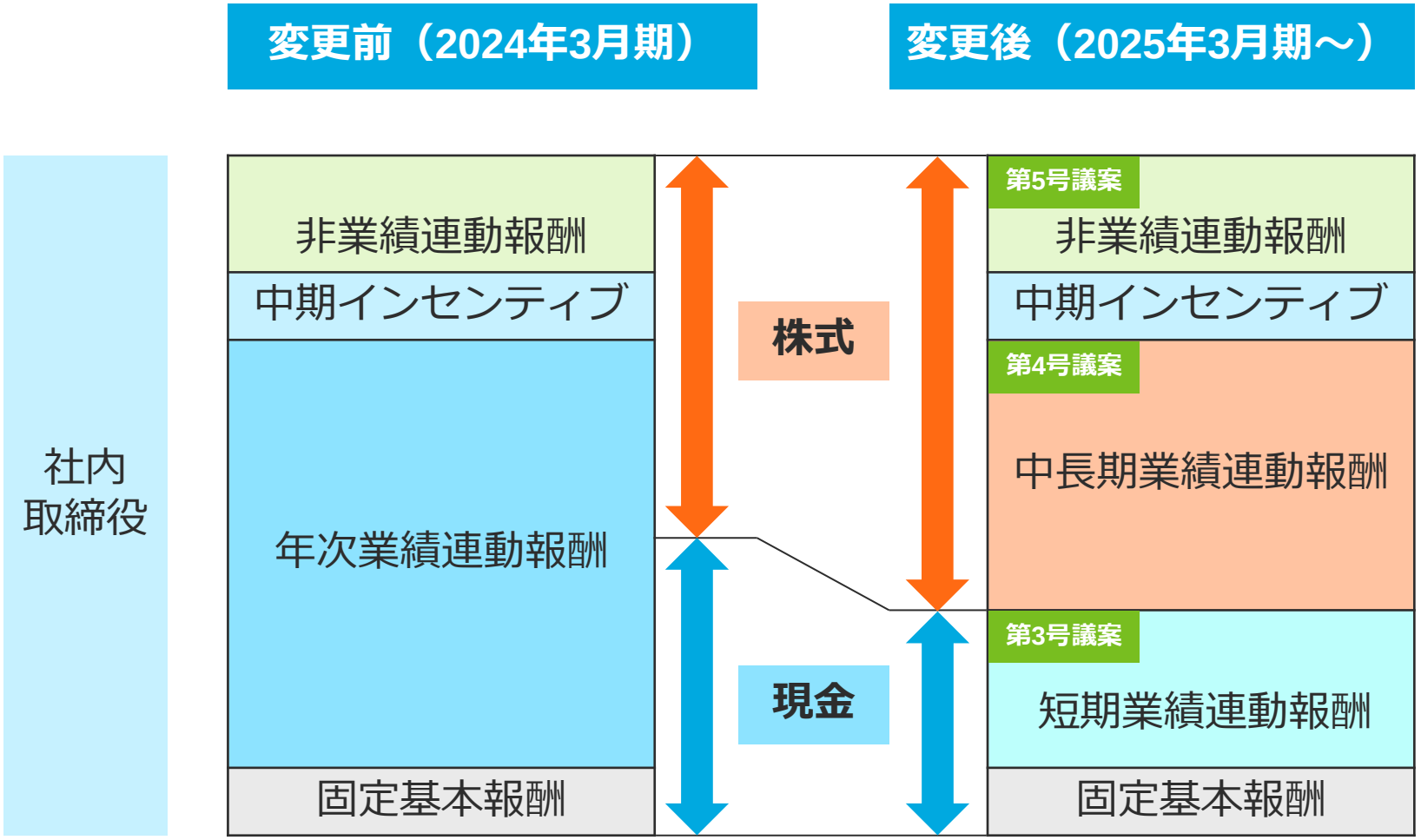
⇒短期及び中期・長期的な利益を同時に
志向し持続的な企業価値向上を促す

報酬決定の透明性・公正性

⇒合理性のある設計、適正な決定プロセス
により報酬の妥当性を確保

役員報酬体系の変更

中長期的な企業価値及び業績向上との連動性を一層強化
（①中長期業績連動報酬の導入　②株式報酬比率アップ）



報酬構成と付議議案の関係について

	固定基本報酬	短期業績連動報酬	中長期業績連動報酬	中期インセンティブ	非業績連動報酬	
	現金		株式			
取締役 (社外取締役を除く)	第58期定時株主総会にてご承認	第3号議案	第4号議案	第55期定時株主総会にてご承認	第5号議案	—
社外取締役		—	—	—	—	第6号議案
監査役	第48期定時株主総会にてご承認	—	—	—	—	—

第３号議案　取締役の短期業績連動報酬額決定の件

第４号議案　取締役の中長期業績連動報酬等の決定の件

第５号議案　取締役の非業績連動報酬等の決定の件

第３号議案～第５号議案 （第６２期）

	対象者	報酬	
第3号議案 (短期業績連動)	取締役 3名	現金	総額　9 億4,600万円
第4号議案 (中長期業績連動)	取締役 2名 （退任取締役1名を除く）	株式報酬型ストック オプション	上限： 260 千株（2,600個） 上限額：付与株式数（個数）×付与時の公正価値 ※支給率：０～165%
第5号議案 (非業績連動)	取締役 2名 （退任取締役1名を除く）	株式報酬型ストック オプション	上限： 60 千株（600個） 上限額：付与株式数（個数）×付与時の公正価値

※対象者：取締役（社外取締役を除く）

第３号議案～第５号議案 （第６３期以降の各事業年度）

	報酬	
第3号議案 (短期業績連動)	現金	1事業年度につき 上限　15億円 ※支給率：０～180%
第4号議案 (中長期業績連動)	株式報酬型ストック オプション	上限： 390 千株（3,900個） 上限額：付与株式数（個数）×付与時の公正価値 ※支給率：０～165%
第5号議案 (非業績連動)	株式報酬型ストック オプション	上限： 90 千株（900個） 上限額：付与株式数（個数）×付与時の公正価値

※対象者：取締役（社外取締役を除く）

第６号議案

社外取締役に対する
株式報酬の額の改定の件

第６号議案　社外取締役に対する株式報酬の額の改定の件

	現行	改定案
株式報酬額	1事業年度につき 総額5,000万円以内	**1事業年度につき 総額1億円以内**
改定理由	**・社外取締役の責務及び期待される役割の増大 ・社外取締役を増員**	

交付等がおこなわれる当社株式等の数の上限15,000株につきましては、
変更しないものとします。

第62期 定時株主総会

TOKYO ELECTRON

2025年6月17日